

2025 JIEP湘南ワークショップ 開催案内

動き出したAI・半導体と実装技術が拓く未来社会
～ 湘南の地でエレクトロニクス実装技術を語ろう！～

招待講演、ナイトセッション講演、ポスター発表 61件 決定！
発表者と徹底議論 一般参加者大募集！

2025年10月20日(月)～21日(火)
会場：レクトーレ葉山 湘南国際村



本音で議論できる様々なしかけ・・・ノーネクタイ・ノースーツで本音トーク！
事業アイデアやビジネスパートナー探し、異業種人脈構築など活用は皆さん次第！！

■ 招待講演1

『次世代半導体に向けた半導体人材育成の活動状況- 九州における事例紹介 -』
青柳 昌宏 様（熊本大学 半導体・デジタル研究教育機構 卓越教授）

■ 招待講演2

『国内、特に九州地区における半導体産業の現在と未来』
植村 聖 様（産業技術総合研究所 九州センター所長）

■ ナイトセッション講演

『心躍る未来を奏でるAI技術の最前線と将来展望』
山本 正晃 様（ニューラルグループ株式会社 取締役 常務執行役員）

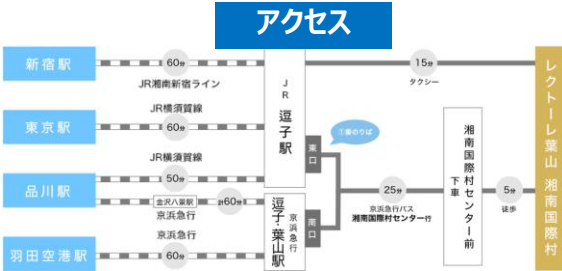
■ ポスター発表（61件）

実装材料、プロセス・接合・装置、パワエレ・カーエレ、AI、信頼性、IoT分野から厳選

2025ワークショップ実行委員会 委員長 野村 健一（産総研）

申込： 湘南ワークショップホームページ（<https://jiep.or.jp/event/workshop/sws2025/>）よりお申し込みください。
参加費用： 正会員・賛助会員:45,000 円 / シニア会員:40,000 円 / 学生会員:35,000 円 / 協賛会員:50,000 円 / 一般:55,000 円
（資料代、宿泊費、食事、消費税を含みます。）
申込締切： 10月3日(金)（ただし、定員になり次第、締め切らせていただきます。）
定員： 130名（先着申込順、発表者含みます）
問合せ先： 〒167-0042 東京都杉並区西荻北 3-12-2
Tel: 03-5310-2010
Email: sws@jiep.or.jp

スケジュール(予定)

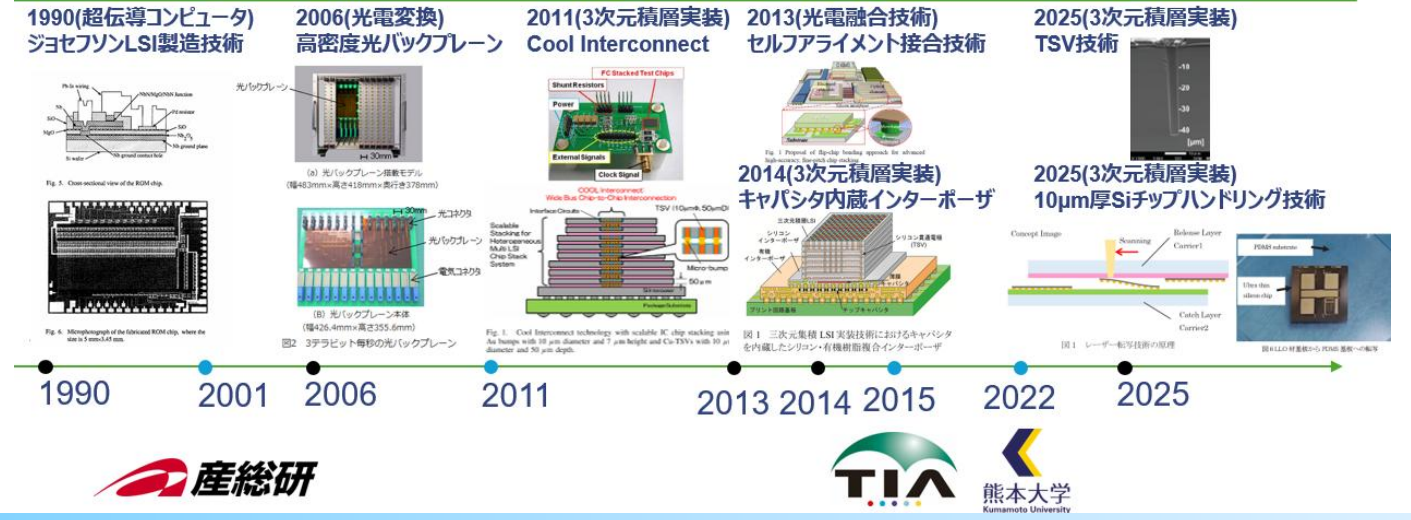


1 日目：10月20日（月）		2 日目：10月21日（火）	
12:30～	登録開始	7:30～ 8:30	朝食
13:35～13:50	オリエンテーション	8:50	2日目セッション開始
13:50～15:15	第1セッション（アブストラクトトーク）	9:00～ 9:50	招待講演 [1]
15:25～17:25	第1セッション（ポスター）	9:50～11:15	第3セッション（アブストラクトトーク）
18:15～19:55	夕食（立食形式懇親会）	11:25～12:25	第3セッション（ポスター前半）
20:15～21:00	ナイトセッション講演	12:25～13:25	昼食
21:00～	第2セッション（自由討論）	13:25～14:25	第3セッション（ポスター後半）
	就寝	14:25～15:15	招待講演 [2]
		15:15～15:55	アンケート・集合写真・閉会式

招待講演① 青柳 昌宏 様

(熊本大学 半導体・デジタル研究教育機構 卓越教授)

2021年に熊本への誘致決定が発表されたTSMCの先端ファウンドリは、2024年12月から量産に入りました。現在、九州における半導体分野は深刻な人材不足の状況です。熊本大学では、九州地域の半導体分野全般に向けた人材供給を目指して、専門教育プログラムを新設しています。高専との教育連携の強化、また、材料・デバイスから応用システムに至る幅広い企業との産学官連携研究開発体制構築などについて、現在の取り組みの状況をご紹介します。



招待講演② 植村 聖 様

(産業技術総合研究所 九州センター所長)

九州地域では半導体関連企業が集積しており、ICの生産が主要産業となっています。近年、TSMCが熊本に進出したことで、その産業がさらに活性化している状況であり、今後、九州地域における半導体関連に関する取り組みが、モデルケースとして全国各地に波及していくものと考えられます。本講演では、九州地域の半導体産業の現状と、その中での産総研の取り組みを中心に紹介します。



ナイトセッション 山本 正晃 様

(ニューラルグループ株式会社 取締役 常務執行役員)

私がAI技術に関わるビジネスに参画するまでに、様々なモノづくりやビジネスを経験してきました。現場で経験してきた楽しさやワクワクをお伝えします。現在は何を生業にしているか？と言われると技術者ではなく、ビジネスをすること、売上をすること、スケールする企業をすることと言えます。自己紹介を交えつつ、最新のAIビジネスの最前線もお伝えします。



■ポスターセッション

10/20(月)		10/21(火)	
実装材料	1.高速通信社会に貢献するパッケージ基板向け層間絶縁材料の開発 大石 凌平/味の素	実装材料	31.RF向けガラス配線基板と個片化技術の開発 澤田石 将士/TOPPAN
	2.AI・高速通信基盤を支える“くつつく”フッ素樹脂と低損失シリカ 森野 正行/AGC		32.エンブラ×発泡で拓く通信の未来 三本 大貴/古河電工
	3.半導体後工程に適應する低誘電ポリイミド樹脂の物性と使用例 山口 貴史/荒川化学工業		33.次世代デバイス向けグラファイト複合放熱部材の開発 俊成 修平/サーモグラフィクス
	4.小型冷却システム実現に向けたMEMSペーパーチャンバーの開発 金子 美泉/日本大学		34.放熱材中のフィラーと樹脂間のフォノン伝導による3次元熱伝達解析 荒尾 修/デンソー
	5.大面積サブミクロンAu粒子バンプの作製方法と評価 藤野 晶仁/田中貴金属工業		35.透明ポリイミド銅張積層板の開発 王 宏遠/日鉄ケミカル&マテリアル
	6.次世代配線板用配線としての無電解ニッケル-リン/銅積層膜の検討 小澤 一樹/関東学院大学		36.リジッド基板製造における高精細インクジェットおよび銅ナノファイバー・プライマー材料の可能性 木口 浩史/エレファントック
	7.樹脂バインダ中でのSn粒子の焼結誘導と導電性接着剤への応用 井上 雅博/群馬大学		37.低温焼結性銅ナノ粒子接合材料系 米澤 徹/北海道大学
プロセス・接合技術・装置	8.Niフリー無電解Auめっきによる高周波特性の効果検証 菊池 悠斗/日本高純度化学	プロセス・接合技術・装置	38.プラズマ処理により微細凹凸形成したPTFE基板への無電解Cuめっき 齊藤 亮太/信州大学
	9.Si-MOSFET製品におけるはんだボイドが過渡熱抵抗に与える影響 林 祐太郎/東芝デバイス&ストレージ		39.焼結接合は密度がポイント！マスターカーブを用いた焼結材の評価技術の開発 碓井 脩斗/東芝
	10.観えなければ測れない 測れなければ作れない 赤外観測と画像測定を用いた先端半導体実装における評価事例 丸門 祥/ミツトヨ		40.先端半導体パッケージの狭ピッチ化に対応する電気試験の開発 真野 悠生/新光電気工業
	11.熱インプリントによる10μmピッチ先鋭Cuマイクロバンプ形成技術の開発 田中 勇登/パナソニックホールディングス		41.基板向け露光装置の最新状況と今後 曽原 直也/ウシオ電機
	12.次世代半導体パッケージ基板における小径ビア形成技術の開発 山岸 はるか/新光電気工業		42.Si貫通電極ウェーハの新たな加工方法について 山本 寛/岡本工作機械製作所
	13.SiCチップ/基板の固相拡散接合プロセスの短時間化 上山 椋平/三菱電機		43.TSV形成のためのエッチングプロセスにおける形状改善に向けたプロセス開発 園田 康太郎/熊本大学
	14.次世代向けパネルレベルパッケージを支える製造技術の開発 山田 志織/アルバック		44.Cu-Cuハイブリッド接合用新規接着材料による積層プロセス検証 加藤 創/三井化学
3D・光・最先端PKG	15.低温接合をめざしたテンプレートストリッピングと直接接合による平滑面およびマイクロバンプの作製 後藤 慎太郎/東北大学	3D・光・最先端PKG	45.世界に先駆けて量産化に成功したOKI独自の半導体異種材料接合技術CFBとは 鈴木 貴人/沖電気工業
	16.TGVガラス洗浄剤の開発 西座 弘明/パーカーコーポレーション		46.ハイブリット接合における洗浄プロセスとCuパッドリセスの関係 小池 美夏/ソニーセミコンダクタソリューションズ
パワエレ・カーエ	17.3D積層デバイス向けTSVのCu pumping評価 山野 友梨子/ソニーセミコンダクタソリューションズ		47.小さな部品にも対応する偽装部品対策とトレーサビリティ 高野 健/リンテック
	18.先端パッケージ（2.xD/3D）に適應したモルディング技術の紹介 久保田 匡/TOWA		48.先端半導体向けレーザー誘導剥離法による転写技術の開発 藤重 遥/東レエンジニアリング
	19.次世代パワー半導体パッケージのための過渡熱抵抗測定システムの開発 福永 崇平/大阪大学		49.車載AI技術の高度化とそれを実現するチップレット実装技術 大澤 青吾/ミライズテクノロジーズ
AI・機械学習	20.超小型SiC両面冷却パワーモジュールの電気・熱・信頼性評価 喜多村 明/東北大学	パワエレ・カーエ	50.車載用廃蓄電池のリユースと再生可能エネルギーによる完全オフグリッド型電力供給システム 下位 法弘/東北工業大学
	21.デジタルツインによるパワーモジュールの信頼性評価手法 石田 和也/先端力学シミュレーション研究所		51.Simcenter Flothermによる方熱伝導ブロックのトポロジー最適化 武井 春樹/シーメンス
	22.パワーデバイスの低温軽量化の多目的最適化への逐次近似最適化手法の適用 岩田 剛治/大阪大学		52.パワーモジュールの熱抵抗と伝熱面積を用いた近似評価 門脇 巨大/横浜国立大学
信頼性評価	23.半導体後工程向けAI活用の取り組み 田辺 健/東芝	AI・機械学習	53.低インダクタンスとSiCジャンクション温度均一化を両立する片面冷却型パワーモジュールの評価 高橋 芳明/IHI
	24.AIを活用した実装基板の信頼性予測～深層モデルの比較～ 竹内 良/東芝		54.次世代太陽電池や有機発光材料の開発に向けたラボオートメーション 角 亮佑/大阪大学
	25.半導体/金属界面の接触抵抗測定による高性能・高信頼性な半導体デバイスの開発 桂 章皓/京都工芸繊維大学		55.AIを活用した実装基板のはんだ印刷品質予測技術 永野 里奈/東芝
	26.ハイブリッド接合界面における接合強度の領域内均一性評価 小林 大季/横浜国立大学	信頼性評価	56.データ特徴を炙り出す！測定スペクトル自動解析の数理アプローチとDX化 柳生 進二郎/NIMS
IoT・ウェアラブル・プリンタブル	27.高信頼性アンダーフィル材開発のための内部ひずみに着目した寿命解析手法 吉田 拓弥/ナミックス		57.DICMを用いた数十マイクロメートルスケール銅バンプの変形・ひずみ評価 藤掛 翔平/鹿児島大学
	28.3GeV放射光施設NanoTerasuとエレクトロニクス 河村 純一/光科学イノベーションセンター		58.Siダイ/アンダーフィル界面の疲労き裂進展におよぼす球状シリカフィラーとSiダイ表面粗さの影響 大木 勇汰/芝浦工業大学
	29.メッシュパターンを自在に制御する新スクリーン印刷版 倉田 祐司/竹田東京プロセスサービス		59.チップ抵抗の熱疲労寿命についての再考 渡辺 岬/東芝
IoT・ウェアラブル・プリンタブル	30.電子ナノ絆創膏と伸縮配線を用いた表面筋電位計測デバイス 山岸 健人/東京大学	IoT・ウェアラブル・プリンタブル	60.“出すだけ”で終わらない！次世代トイレでできるカジュアル健康管理 浅井 開/ファーストスクリーニング
			61.ふるえが止まらない 極薄ハブティクス続報 竹井 裕介/産総研